



Dünndraht Wedge-Wedge Bonder 5830

Bond System

Drahttypen	Alu- und Golddrähte 17,5-75µm auf 2"-Spule
Bondkopf	Wedge-Wedge für Alu- und Golddrähte Standardkapillare 1" Länge, 45° Drahtzuführung Motorisierte Drahtabspulung (optional)
Ultraschall System	F&S US System 100 kHz (optional 65, 140 kHz)

Maschinen Basis

Achsen

- Arbeitsbereich X/Y-Achse 200x150mm
- Schrittauflösung 1µm programmierbar
- Programmierbare Z-Achse mit 100mm Hub

Hardware

- Dual-Core PC mit Windows OS Ethernet,
- USB 2.0/3.0, LCD Farbdisplay 22"
- GigE-CMOS-Farbkamera mit 5 MPixel
- Netzwerkfähig mit Programm-Archivierung

Software

- Einzelbonds bis komplexe Programme,
- Loopformen in Bibliotheken speicherbar
- Optionale Bilderkennung

Steuerung

- Hochleistungseembedded ARM-System mit Echtzeitbetriebssystem für Präzisions-Bahnkurven
- 1 Draht / Sekunde

Platziergenauigkeit +/- 5µm @ 3 sigma, inkl. Tool/ohne Draht auf F&S Bondtec Standard-Substrat

Wiederholgenauigkeit +/- 3 µm @ 3 sigma, inkl. Tool/ohne Draht auf F&S Bondtec Standard-Substrat

Loophöhengenaugigkeit +/- 5µm @ 3 sigma, bei Dünndraht 5830 mit 25µm Aluminium Draht auf F&S Bondtec Standard-Substrat

Die 58xx Serie:

Die Dünndraht Wedge-Wedge-Variante der automatischen Drahtbonder unserer Serie 58 mit austauschbaren Bondköpfen.

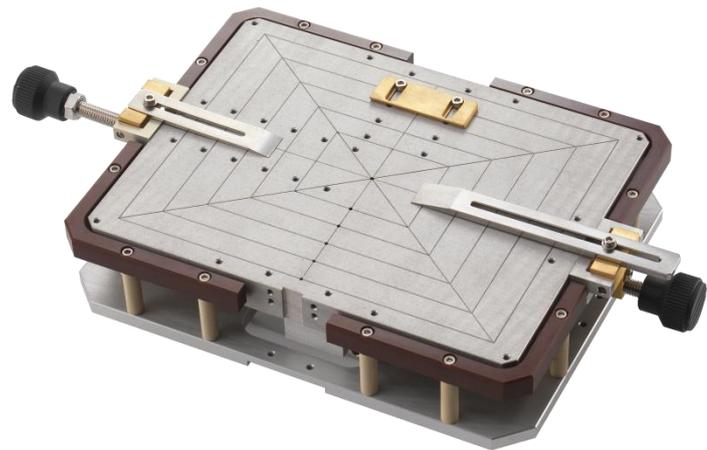
Ideal geeignet für die Fertigung, da automatisch einsetzbar mit einer Bondgeschwindigkeit von typisch ein Draht pro Sekunde. Bauteilwechsel durch Bediener, der Bondablauf ist dank eingebauter Bilderkennung völlig bedienerfrei.

Einzelbonds sind in Sekunden herstellbar, daher auch perfekt für R&D, Pilotfertigung und Serienfertigung mit mittleren Losgrößen geeignet!

Abmessung B x T x H – 92 x 71 x 65 cm, Gewicht ca. 80kg
Anschlüsse 100-240 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max 230 VA,
Ø 6mm Standard-Vakuumschlauch
Heizung Steuerung in der Maschine integriert 0-250 °C

Substrathalter

Standard-Substrataufnahme
für Bauteile bis 8x6" mit
Vakuum und mechanischer Klemmung



Optional:



Vakuumaufnahme 6x6"
mit mechanischer Klemmung



TO Aufnahme mit
mechanischer Klemmung



4x4" Substrataufnahme m.
gummierter Oberfläche, mit
mechanische Klemmung

F&S Bondtec Semiconductor GmbH

Industriezeile 49a

A-5280 Braunau am Inn

Tel.: +43-7722-67052-8270

Fax: +43-7722-67052-8272

Mail: info@fsbondtec.at

Web: www.fsbondtec.at

Hilpert
electronics

Ihr Vertriebspartner/ Votre représentant:

Hilpert electronics AG

Täferenstrasse 29

5405 Baden-Dättwil

Schweiz / Suisse

Tel: +41 56 483 25 25

Fax: +41 56 483 25 20

Mail: office@hilpert.ch

Web: www.hilpert.ch

